

2017-2022年中国PCB行业市场发展现状及十三五 发展机会分析报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2017-2022年中国PCB行业市场发展现状及十三五发展机会分析报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/dianzishebei/277601277601.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

全球电子信息行业，智能手机在过去几年的增长驱动着PCB行业的成长，但也已经接近饱和，只会有小幅增长；数据中心设备需求在持续成长；可穿戴设备被认为是未来新的电子行业增长驱动力；PC行业则仍会持续衰退；汽车电子被认为将会持续发展。整体来看，诸如PC和消费电子的疲软影响了2015年PCB行业的市场境况。激烈的市场竞争、迅速下降的成本、货币贬值加剧如日元、欧元等，对PCB市场持续增加影响。

2015年整体全球PCB市场下降，产值为635.24亿美元。其中，载板市场下降8.9%，HDI下降3.3%，普通硬板及多层板下降幅度在4.1-5.2%之间，作为唯一的亮点，FPC成长2.8%，因为其应用范围的扩大。以地区来看，依然没有较大变化，中国增速不大，2015全年我国PCB产值合计171.96亿美元，年成长率为1.79%。日本韩国等地区份额持续下降。

我国PCB市场巨大的发展空间吸引了大量国际企业的进入，绝大部分世界知名PCB生产企业都在我国建立了生产基地，并在积极扩张。目前，我国PCB市场形成了台资、港资、美资、日资、韩资以及本土内资企业多方共同竞争的格局。其中，外资企业普遍投资规模较大，生产技术和产品专业性都有一定优势；内资企业数量众多，但企业规模和水平与外资企业相比仍存在一定差距。本土企业面临着严酷的经营条件，这是因为在生产设备、测试手段、计算机管理和市场竞争理念方面存在着诸多不平衡。

未来，PCB生产整合了最先进的技术，并还将继续应用一些更新的先进技术，诸如液态感光成像、直接电镀、脉冲电镀以及逐渐增加的积层板等。在生产中，还应当考虑减少废气、污水和固体废弃物的排放来获得持续的发展。在将来，有赖于新材料、新设备和新技术的应用，PCB生产将可实现低成本、高效率、污染少和高质量。生产PCB专业设备的行业，则从低水平的仿制转向自动化、高精度、多功能和现代化设备的生产。

PCB产业链

印刷电路板1948年开始应用于商业，自20世纪50年代中期起被广泛采用，经过几十年的不断发展，PCB已成为全球性大行业。根据Prismark统计，2015年全球PCB行业总产值553亿美元。

200-2022年全球PCB产值及增速

中国报告网发布的《2017-2022年中国PCB行业市场发展现状及十三五发展机会分析报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

第一章PCB行业概述

1.1PCB的介绍

1.1.1PCB的定义

1.1.2PCB的分类

1.1.3PCB的特点

1.2PCB的链

1.2.1PCB链的构成

1.2.2产业链中的产品介绍

1.3PCB行业标准

1.3.1国际标准

1.3.2国内标准

1.4PCB特点

1.4.1电路板属订单型生产形态

1.4.2电路板的制造流程长且复杂

1.4.3电路板属资本密集型行业

1.4.4电路板的议价能力相对较弱

第二章全球PCB行业发展分析

2.12014-2016年全球PCB市场情况分析

2.1.12014-2016年全球PCB行业格局分析

2.1.22014-2016年全球PCB产品结构分析

2.1.32016年全球PCB行业发展分析

2.22014-2016年主要国家地区PCB市场分析

2.2.12014-2016年日本PCB市场分析

2.2.22014-2016年韩国PCB市场分析

2.2.32014-2016年北美PCB市场分析

2.2.42014-2016年台湾PCB市场分析

1、台湾PCB市场总体分析

2、台湾PCB之市场分析

3、台湾PCB之群聚与结构

4、台湾PCB之竞争力分析

2.2.52014-2016年欧洲PCB市场分析

第三章中国PCB行业发展分析

3.1中国PCB行业发展概述

3.1.1中国PCB行业发展简史

3.1.2中国PCB行业发展特点

3.1.3中国PCB行业发展总体分析

3.1.4中国PCB工业发展情况分析

3.2中国PCB行业发展面临的问题

3.2.1美国重塑制造业影响中国制造业

3.2.2PCB设备仪器企业发展不够快

3.2.3PCB原辅料企业还很弱小

3.2.4从事PCB环保的企业缺乏特色

3.32016年中国PCB行业市场分析

3.3.12016年中国PCB行业发展现状

3.3.22016年中国PCB市场规模分析

3.3.32016年中国PCB产品结构分析

3.42016年中国PCB产品供需分析

3.4.12016年PCB产品需求分析

3.4.22016年HDI板产品需求分析

3.4.32016年手机PCB产品需求分析

3.4.42016年终端产品对PCB需求分析

3.52016年中国PCB设备发展分析

3.5.12016年PCB制造设备市场分析

3.5.22016年PCB高端设备存在的问题

3.5.3中国PCB专用设备制造发展趋势

第四章深圳PCB发展分析

4.1深圳PCB回顾

4.1.1深圳PCB总体情况

4.1.2深圳PCB发展分析

4.2深圳PCB未来发展

4.2.1未来深圳PCB市场分析

4.2.2未来深圳PCB格局

4.3深圳PCB发展趋势

4.3.1迈向高端制造

4.3.2发力服务

4.4深圳PCB启示与总结

4.4.1制造业完善链的启示

4.4.2深圳PCB总结

第五章PCB上游原材料市场分析

5.1铜箔

5.1.1铜箔的相关概述

5.1.2铜箔的全球供应状况

5.1.3铜箔在柔性PCB中的应用

5.1.4电解铜箔的发展分析

5.2环氧树脂

5.2.1环氧树脂的相关概述

5.2.2环氧树脂的应用领域

5.2.3中国环氧树脂的市场前景

5.2.42016年环氧树脂市场走势分析

5.2.5PCB用环氧树脂发展趋势

5.3玻璃纤维

5.3.1玻璃纤维的相关概述

5.3.2中国玻璃纤维面临巨大市场需求

5.3.32016年中国玻璃纤维行业经济运行情况

5.3.42016年中国玻璃纤维的发展情况

第六章PCB下游应用领域分析

6.1消费类电子产品

6.1.12016年中国消费电子产品走向高端

6.1.2消费电子用PCB的市场需求稳定增长

6.1.3高端电子消费品市场需求带动HDI电路板趋热

6.1.4消费电子行业未来发展市场调查分析

6.2通讯设备

6.2.12016年中国通讯设备制造业发展情况

6.2.2未来移动通信设备的趋势

6.2.3语音通讯移动终端用PCB的发展趋势

6.3汽车电子

6.3.1PCB成为汽车电子市场的热点

6.3.2多优点PCB式汽车继电器市场不断壮大

6.3.32016年全球汽车电子PCB市场发展分析

6.4LED照明

6.4.12016年中国LED照明的发展状况

6.4.2LED发展为PCB行业带来新需求

6.5电脑及相关产品发展分析

6.5.12016年电脑及相关产品市场情况

6.5.22016年国内电脑市场需求分析预测

6.6工业及医疗电子市场发展分析

6.6.12016年工业电子市场发展分析

6.6.22016年医疗电子市场发展分析

6.6.32016年医疗电子市场机遇分析

第七章PCB市场行为研究

7.1消费者行为研究

7.1.1PCB性能表现及认知

7.1.2消费者主要流向研究

7.1.3消费者对PCB的品牌认知

7.1.4消费者对PCB的评价

7.2PCB终端研究

7.2.1渠道商推荐品牌

7.2.2如何打动PCB采购商

第八章PCB制造技术的研究

8.1PCB芯片封装焊接方法及工艺流程的阐述

8.1.1PCB芯片封装的介绍

8.1.2PCB芯片封装的主要焊接方法

8.1.3PCB芯片封装的流程

8.2光电PCB技术

8.2.1光电PCB的概述

8.2.2光电PCB的光互连结构原理

8.2.3光学PCB的优点

8.2.4光电PCB的发展阶段

8.3PCB抄板

8.3.1PCB抄板简介

8.3.2PCB抄板技术流程

8.3.3PCB抄板技术价值分析

8.3.4PCB抄板发展趋势

8.4PCB技术的发展趋势

8.4.1沿着高密度互连技术（HDI）道路发展下去

8.4.2组件埋嵌技术具有强大的生命力

8.4.3PCB中材料开发要更上一层楼

8.4.4光电PCB前景广阔

8.4.5制造工艺要更新、先进设备要引入

第九章PCB行业竞争格局分析

9.1PCB行业竞争格局概况

9.1.1区域集中度分析

9.1.2市场集中度分析

9.1.3企业集中度分析

9.2PCB行业竞争情况五力分析

9.2.1同业之间的竞争比较激烈，市场集中度低

9.2.2目前尚没有能够替代印刷电路板的成熟技术和产品

9.2.3整机装配厂家增加inhouse布局以降低成本

9.2.4供应商的集中度比较高，议价能力比较强

9.2.5消费类电子中整机产品价格不断下滑，工业类电子产对PCB的价格不敏感

9.3中国PCB研发力分析

9.3.1PCB研发重要性分析

9.3.2中国PCB研发力问题分析

9.42014-2016年PCB品牌竞争分析

9.4.12016年销售前10名PCB品牌

9.4.22017-2022年PCB品牌竞争趋势

9.5PCB行业竞争动态分析

9.5.1PCB厂转移阵地竞争激烈

9.5.2PCB行业潜在进入者威胁

9.5.3PCB新技术打破竞争格局

9.5.4PCB上游原材料竞争动态

第十章国外重点PCB制造商介绍

10.1日本企业

10.1.1日本揖斐电株式会社（IBIDEN）

10.1.2日本旗胜（NipponMektron）

10.1.3日本CMK公司

10.2美国企业

10.2.1MULTEK

10.2.2美国TTM

10.2.3新美亚（SANMINA-SCI）

10.2.4惠亚集团（Viasystems）

10.3韩国企业

10.3.1三星电机 (SamsungE-M)

10.3.2永丰 (YoungPoongGroup)

10.3.3LGElectronics

10.4台湾企业

10.4.1欣兴电子股份有限公司

10.4.2健鼎科技股份有限公司

10.4.3雅新电子集团

第十一章国内PCB重点企业发展分析

11.1PCB企业排名情况

11.1.1PCB企业排名及销售收入情况

11.1.2覆铜箔板企业排名及销售收入情况

11.1.3专用材料企业排名及销售收入情况

11.1.4专用化学品企业排名及销售收入情况

11.1.5专用设备和仪器企业排名及销售收入情况

11.1.6环保洁净企业排名及销售收入情况

11.2广东生益科技股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

11.3方正科技集团股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

11.4广东汕头超声电子股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

11.5广东超华科技股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

11.6天津普林电路股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

11.7其他重点PCB企业发展分析

11.7.1瀚宇博德科技（江阴）有限公司

11.7.2广州添利电子科技有限公司

11.7.3珠海紫翔电子科技有限公司

11.7.4沪士电子股份有限公司

11.7.5南亚电路板（昆山）有限公司

11.7.6联能科技（深圳）有限公司

11.7.7名幸电子（广州南沙）有限公司

11.7.8广州宏仁电子工业有限公司

11.7.9惠州中京电子科技股份有限公司

11.7.10深圳市艾诺信射频电路有限公司

11.7.11常州安泰诺特种印制板有限公司

11.7.12敬鹏（苏州）电子有限公司

11.7.13珠海紫翔电子科技有限公司

11.7.14上海埃富匹西电子有限公司

11.7.15深圳市景旺电子股份有限公司

11.7.16昆山万正电路板有限公司

11.7.17江门世运电路板科技股份有限公司

11.7.18嘉联益科技股份有限公司

11.7.19苏州福莱盈电子有限公司

11.7.20东莞五株科技

11.7.21广州杰赛科技股份有限公司

11.7.22深圳博敏电子股份有限公司

11.7.23深圳市众嘉鑫电路科技有限公司

11.7.24泰州市博泰电子有限公司

第十二章PCB企业竞争策略分析

12.1PCB市场发展潜力分析

12.1.1PCB市场增长潜力分析

12.1.2PCB主要潜力品种分析

12.2PCB企业市场策略分析

12.2.1PCB价格策略分析

1、决定PCB价格的因素

2、PCB定价策略

12.2.2PCB渠道策略分析

12.3PCB企业销售策略分析

12.3.1产品定位策略分析

12.3.2促销策略分析

12.4PCB企业经营策略分析

第十三章PCB行业发展趋势分析

13.1PCB行业发展前景分析

13.1.1全球PCB行业发展前景分析

13.1.2中国PCB行业发展前景分析

13.22017-2022年中国PCB发展趋势分析

13.2.12017-2022年PCB政策趋向

1、PCB政策趋向

2、PCB十三五规划项目重点

13.2.22017-2022年PCB技术革新趋势

13.2.32017-2022年PCB价格走势分析

13.2.42017-2022年PCB产品趋势分析

13.2.52017-2022年PCB营销趋势分析

13.32017-2022年中国PCB市场趋势分析

13.3.12017-2022年中国PCB市场发展趋势

13.3.22017-2022年中国PCB市场发展空间

13.4未来PCB行业全球发展动向

13.4.1韩国PCB业高速发展

13.4.2最新版PCB技术推出

第十四章未来PCB行业发展预测

14.12017-2022年全球PCB市场预测

14.1.12017-2022年全球PCB行业产值预测

14.1.22017-2022年全球PCB市场需求预测

14.22017-2022年中国PCB市场预测

14.2.12017-2022年中国PCB行业产值预测

14.2.22017-2022年中国PCB市场需求预测

第十五章PCB行业投资环境分析

15.1政策环境对行业发展的影响分析

15.1.1人民币升值

15.1.2新企业所得税法

15.1.3环保问题与ROHS标准

15.1.4新劳动合同法的实施

15.1.5节能减排对行业发展的影响

15.2中国经济发展环境分析

15.2.12016年中国宏观经济运行情况

15.2.22016年中国电子信息经济运行分析

15.2.32016年中国电子元器件经济运行分析

15.3社会发展环境分析

15.4技术发展环境分析

15.4.1电镀技术是行业发展的关键

1、PCB电镀工艺发展

2、水平电镀工艺在PCB电镀里的应用

15.4.2世界PCB技术发展分析

1、印制电路板制造技术发展

2、在关键工艺技术发展趋势

3、印制电路板检测技术发展分析

第十六章PCB行业投资机会与风险

16.1PCB行业关联度

16.1.1集成电路离不开印制板

16.1.2高新技术产品少不了印制板

16.1.3现代科学和管理体现在印制板

16.1.4当代电子元件业中最活跃的

16.2PCB行业投资SWOT分析

16.2.1优势

16.2.2劣势

16.2.3机会

16.2.4威胁

16.3行业进入壁垒

16.3.1资金壁垒

16.3.2技术壁垒

16.3.3环保壁垒

16.3.4客户认可壁垒

16.4投资风险分析

16.4.1经营环境日趋严峻

16.4.2三高问题难以解决

16.4.3新厂选址问题分析

16.5小批量PCB行业发展影响因素分析

16.5.1有利因素

16.5.2不利因素

第十七章PCB行业投资现状与建议

17.1PCB行业投资现状

17.1.1投资规模情况

17.1.2投资区域情况

17.2PCB行业投资建议

17.2.1PCB投资时机选择

17.2.2PCB产品结构选择

17.2.3PCB投资区域选择

17.2.4PCB投资发展建议

第十八章PCB行业投资战略研究

18.1PCB行业经营模式发展分析

18.1.1生产模式

18.1.2销售模式

18.1.3采购模式

18.2对中国PCB品牌的战略思考

18.2.1PCB企业实施品牌战略的意义

18.2.2品牌战略在企业发展中的重要性

18.2.3PCB企业品牌的现状分析

18.2.4中国PCB企业品牌战略

18.3民营PCB企业的发展与思考

18.3.1企业应审视经营环境明确经营战略

18.3.2管理制度的导向作用对发展的影响

18.3.3认识资本运作魅力与企业发展规律

18.3.4重视企业文化及放权与监督制度化

18.4PCB行业投资战略研究

18.4.1成本战略研究

18.4.2技术创新战略

18.4.3规范战略

18.4.4信息化发展战略

18.4.5人才整合战略

图表目录：

图表：PCB产业链图解

图表：全球印刷线路板企业格局

图表：2015-2016年全球不同地区PCB所占比例分析

图表：2016年中国台湾和内地PCB产值分布表（按生产地区）

图表：2014年中国台湾PCB行业主要上市公司营收情况

图表：2015年中国台湾PCB行业主要上市公司营收情况

图表：2016年中国台湾PCB行业主要上市公司营收情况

图表：欧洲地区主要PCB生产商

图表：2014-2016年德国PCB产业进出口数据分析

图表：2006-2016年PCB专用辅料市场规模

图表：2014-2016年中国PCB电路板产量情况

图表：2014-2016年中国PCB电路板行业供需平衡情况

图表：2014-2016年中国PCB行业市场规模情况

图表：全球电子整机产品产值分析及预测

图表：2006-2016年中国大陆PCB设备市场规模

图表：2006-2016年中国PCB检测与外形加工设备市场规模

图表：2006-2016年中国PCB专用辅助材料市场规模

图表：铜箔的分类

图表：压延铜箔的生产过程示意图

图表：铜箔的处理阶段和稳定性

图表：2014-2016年中国电解铜箔行业的市场规模

图表：2014-2016年全球电解铜箔产值情况

图表：2014-2016年全球铜箔产值年增长率及预测

图表：2016年全球电解铜箔产量主要地区分布情况

图表：环氧树脂胶粘剂的主要用途

图表：2014-2016年国内外环氧树脂消费量情况

图表：玻璃纤维同主要复合材料性能参数比较

（GYZX）

图表详见正文

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/dianzishebei/277601277601.html>